

中信证券股份有限公司
关于上海灿瑞科技股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责灿瑞科技上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与灿瑞科技签订保荐及承销协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度灿瑞科技在持续督导期间未发生按有关规定必须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内，向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年度灿瑞科技及其相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解灿瑞科技经营情况，对灿瑞科技开展了持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2023 年上半年度，保荐机构督导灿瑞科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则

序号	工作内容	实施情况
		及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促灿瑞科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对灿瑞科技的内部控制制度的实施和有效性进行了核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，灿瑞科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促灿瑞科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对灿瑞科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	灿瑞科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	灿瑞科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项

序号	工作内容	实施情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度，灿瑞科技未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年上半年度，灿瑞科技不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年 1-6 月，保荐机构和保荐代表人未发现灿瑞科技存在重大问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、新产品研发及技术迭代的风险

集成电路行业属于技术密集行业，下游应用领域广泛，其中智能手机、平板电脑等消费电子领域的更新换代较快，集成电路产品需紧跟下游应用领域的变化进行产品创新与升级，公司经过多年对智能传感器芯片、电源管理芯片等产品的研发，已积累了一批核心技术，并在行业内具备较强的竞争优势。但随着终端客户对产品技术及应用需求的不断提高，行业新技术、新产品及新方案不断涌现，公司需要持续进行研发投入和技术创新，不断更新现有产品品类并研发新技术和新方案，保持核心技术的先进性和主营产品的竞争力。

如果公司未来不能保持持续的创新能力和准确把握行业、技术的发展方

向，导致新产品研发进度和技术迭代周期无法匹配行业发展和客户需求的变化，将使公司无法在市场竞争中占据优势地位，并给公司未来业务拓展和经营业绩带来不利影响。

2、核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列具有自主知识产权的核心技术，并形成较完善的技术体系。为保护自身的核心技术，公司制定了严格的保密措施，与核心技术人员及研发骨干签署了保密协议，并通过申请专利、集成电路布图设计、计算机软件著作权等方式进行产权保护。同时，公司尚有多项产品和技术解决方案正处于研发阶段，公司在新产品产业化过程中需要和产业链上游厂商紧密合作，如果未来核心技术人员流失或者在生产经营过程中相关技术、数据、图纸等保密信息泄露，可能存在核心技术泄密或被外界盗用的风险，从而对公司保持核心竞争力造成不利影响。

3、技术人员流失的风险

集成电路行业是典型的知识和技术密集型行业，对研发人员的半导体物理学、半导体材料学、微电子与系统学、信息学等学科的理论基础以及从业经验有较为严格的要求，优秀的技术人员需要精通半导体电路设计、工艺开发、集成电路验证与测试等多项技术，且经过较长时间的技术积淀才可参与或主导相关产品的研发与设计。国内集成电路企业经过多年的技术沉淀，已经积累了一批人才，但与国际领先集成电路厂商相比，高端专业人才仍相对稀缺，由于国内集成电路企业发展迅速，人才竞争也日趋激烈。

公司目前已建立了一支多层次、高素质、经验丰富的研发技术团队，且形成了良好的薪酬与激励机制，但如果随着未来市场竞争的加剧，公司不能继续保持对技术人员在薪酬水平、激励机制方面的吸引力，将存在技术人员流失的风险，对公司保持竞争力和业务的持续发展造成不利影响。

（二）经营风险

1、业绩大幅下滑或亏损的风险

2023 年上半年，公司实现营业收入 19,143.53 万元，同比减少 40.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-834.34 万元，同比减少 109.95%，主要系受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响。

公司未来业绩变化，将受公司内外部因素的综合影响。外部方面，将可能受到宏观经济、行业发展及竞争态势、上下游产业发展等方面的影响。内部方面，将可能受到公司技术研发、市场推广等方面的影响。随着当前宏观经济形势和终端需求变化，在此背景下，若经济增速放缓，导致智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备等下游领域的发展放缓，或者公司无法准确把握下游需求的变化和行业发展趋势，导致对下游领域的拓展和渗透不及预期，公司未来可能面临业绩大幅下滑或亏损的风险。

2、市场竞争加剧且市场占有率难以快速提升的风险

公司所在的高性能集成电路行业正经历快速发展，广阔的市场空间吸引了诸多国内外企业进入这一领域，行业内厂商在巩固自身优势基础上积极进行技术研发和市场拓展，行业竞争有加剧的趋势。目前公司所处行业主要由欧美、日韩等国际领先企业主导，公司在智能传感器芯片和电源管理芯片领域的市场占有率与同行业国际领先企业相比仍存在一定差距。

如果公司不能正确把握市场发展机遇和行业发展趋势，不能适应激烈的竞争环境并保持产品的高品质和供货的稳定性，或者不能保持行业内的技术领先，则可能导致在市场竞争中处于不利地位，且市场占有率难以快速提升。

3、封装测试服务产能消化风险

公司报告期内采用“Fabless+封装测试”经营模式，能够形成芯片设计业务、封装测试业务的研发协同、生产协同和质量协同，提升核心竞争力，但由于封装测试产线固定资产投资金额较大，且存在一定的生产经营管理难度，对公司的经营管理具有一定的挑战。同时，公司封装测试优先为自研芯片提供服务，考虑到未来业务增长空间、产品布局完善、产能逐步释放等因素，公司对封装测试服务进行一定的前瞻性战略布局和产能建设储备。根据公司未来发展战略，对封装测试业务将采取逐步投入、紧跟芯片产品布局的规划安排，在优先满足内部封测需求后，适量承接外部封测业务。

但是，如果未来公司自研芯片下游应用领域需求放缓，新产品研发及新客户开拓未能实现预期目标，上游晶圆产能持续紧张无法缓解，或者市场环境发生重大不利变化，自研芯片产量及销量增速较慢甚至下滑，外部封装测试订单需求不足，公司将存在封装测试产能无法有效利用并及时消化的风险，导致预计收入无

法覆盖固定资产折旧等成本，从而对公司经营业绩产生不利影响。同时，如果未来随着封装测试服务产能的持续扩大，公司的人员管理、生产运营管理能力无法同步提升，将存在封装测试服务业务经营效益无法提升甚至进一步下滑的风险。

4、供应商集中的风险

报告期内，公司的经营采购主要包括晶圆制造和封装测试服务，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。但由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，出于工艺稳定性等方面的考虑，与公司合作的晶圆厂和封测厂较为集中。如果供应商发生重大自然灾害等突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能排期紧张、交期延迟等因素，部分供应商产能可能无法满足公司需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

5、产品质量控制的风险

良好的产品质量是公司保持市场竞争力的基础。公司已经建立并执行了较为完善的质量控制体系，但由于芯片产品具有高度复杂性，产品质量受到设计、生产流程中诸多因素的影响。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的赔偿责任，并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响。

（三）财务风险

1、毛利率存在可能无法持续增长的风险

公司正处于业务快速发展的阶段，毛利率主要受下游市场需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本、公司技术水平等多种因素影响。若上述因素发生持续不利变化，公司毛利率存在可能无法持续增长甚至出现下滑的风险，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

2、应收账款回收的风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务的快速发展。如果公司采取的收款措施不力或上述客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生坏账风险的可能性将会增加。

3、存货跌价的风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、在产品、库存商品等构成。随着市

场需求的不断增长以及公司业务规模的持续扩大，公司存货规模呈上升趋势。如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

4、汇率波动的风险

近年来国家根据国内外经济金融形势和国际收支状况，不断推进人民币汇率形成机制改革，增强了人民币汇率的弹性。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，有可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

5、税收优惠风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。如果未来公司所享受的税收优惠政策发生较大变化，将会对公司的盈利水平产生一定的影响。

（四）行业风险

集成电路行业是面临全球化的竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业，受到国内外宏观经济、行业法规和产业政策等因素的影响，存在一定的周期性。近年来，国内外宏观经济形势总体平稳，同时国家高度重视半导体行业的高质量发展，相继出台了若干支持性政策，为行业发展创造了良好的机遇。未来，如果国内外宏观经济环境或行业景气度发生不利变化，或国家相关产业政策对集成电路行业的支持力度减弱，则公司的经营将受到一定的不利影响。

（五）其他重大风险

1、实际控制人风险

截止本报告期末，罗立权直接持有灿瑞科技 2.59%的股份；同时，景阳投资直接持有灿瑞科技 45.25%的股份，罗立权与罗杰合计直接持有景阳投资 99%的股份，对景阳投资拥有控制权；上海骁微和上海群微分别直接持有灿瑞科技 6.48%的股份，罗立权为上海骁微和上海群微执行事务合伙人，对外代表合伙企业，执行合伙事务。因此，罗立权和罗杰合计控制灿瑞科技股份表决权总数的 60.8%。

罗立权与罗杰系父子关系，为灿瑞科技共同实际控制人，对公司重大经营决策有实质性影响。若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配等重大事项进行干预，将可能损害公司其他股东的利益。

2、募投项目风险

若在项目实施过程中，外部环境出现重大变化，可能导致募投项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。如果研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，则募集资金投资项目可能面临研发失败或市场化推广失败的风险，前期的研发投入将难以收回，募集资金投资项目预计效益难以实现，对公司业绩产生不利影响。

四、重大违规事项

2023 年 1-6 月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023 年 1-6 月	2022 年同期	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	191,435,316.93	321,290,997.76	-40.42
归属于上市公司股东的净利润	-8,343,409.50	83,861,252.37	-109.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,719,834.02	81,766,523.96	-137.57
经营活动产生的现金流量净额	-57,802,426.33	28,760,889.23	-300.98
	本期末	上年度末	本期比上年同期 增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	2,531,482,275.82	2,572,091,961.67	-1.58
总资产	2,676,505,222.79	2,718,030,450.73	-1.53

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年 1-6 月	2022 年同期	本期比上年同期 增减（%）
基本每股收益 （元 / 股）	-0.11	1.45	-107.59
稀释每股收益（元 / 股）	-0.11	1.45	-107.59

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.40	1.41	-128.41
加权平均净资产收益率（%）	-0.32	17.52	减少 17.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.20	17.08	减少 18.28 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	28.43	9.15	增加 19.28 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，公司营业收入较上年同期下降 40.42%，在宏观经济行业整体下行的情况下，公司在第二季度采取积极的价格策略，努力扩大市场份额，且受益于良好的产品方向规划及传感器业务的竞争格局，第二季度公司实现大幅收入改善，2023 年第二季度公司实现营业收入 11,993.58 万元，较 2023 年第一季度环比增长 67.74%；

2、报告期内公司加大研发投入力度，加快新产品研发速度，研发费用大幅增加，研发费用中人员薪酬费用增加 1,077.48 万元，同时 2023 年第二季度公司为激励核心人员实施股权激励计划，本期增加股份支付费用 1,022.32 万元。

综合上述原因，本报告期归属于上市公司股东的净利润以及经营活动产生的现金流量净额下降较多，若扣除本期新增股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润约为 187.98 万元。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、出色的研发能力，产品核心技术处于领先水平

研发能力和技术水平是集成电路企业的重要核心竞争力。公司一贯重视技术研发，经过多年的研发投入和技术积累，在智能传感器芯片和电源管理芯片的研发设计、封装测试领域积累了丰富的研发经验。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已取得内地专利 80 项（其中发明专利 27 项），港澳台及境外专利 16 项（其中发明专利 12 项），集成电路布图设计专有权 80 项，软件著作权 7 项，形成完整的自主知识产权体系。公司“高性能磁传感器系统及芯片关键技术的研发和应用”课题于 2020 年荣获上海市科技进步奖二等奖；同年，公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。此外，公司“双极锁存型霍尔开

关电路”、“非隔离准谐振降压 LED 恒流驱动器”、“数字 I2C 通讯接口 LCD 屏幕偏压驱动器”、“数字一线通讯接口双路大电流 LED 闪光驱动器”和“H 桥电机驱动器”产品为上海市高新技术转化项目，并建立院士专家工作站。

在智能传感器芯片领域，公司基于“嵌入式集成磁传感器智能 H 桥驱动电路设计技术”、“基于主动式虚通道可编程参数配置的磁传感系统芯片架构技术”、“微功耗 CMOS 传感器信号处理技术”等核心技术，形成超过 400 款智能传感器芯片产品，完成了高可靠性、高精度、低噪声、超低功耗、集成化等关键技术突破，主要产品的技术性能达到国际先进水平，可以与国际知名磁传感器芯片厂商的同类产品竞争。同时，公司紧跟光传感器芯片的前沿研发方向，把握结构光技术和 TOF 技术下光源芯片的发展趋势，成功研发出符合市场需求的 IR 和 VCSEL 发射器及驱动芯片，且已应用于智能安防和人脸支付领域知名厂商的产品中。

在电源管理芯片领域，公司积累了“高精度低纹波电流输出直流转换电源电路设计技术”、“宽幅高线性调光控制技术”、“自适应高精度恒定电流控制技术”等核心技术，形成超过 200 款电源管理芯片产品，在低功耗、过压过流过温保护、输出效率等方面建立了自身的技术优势。

此外，公司紧跟智能传感器芯片和电源管理芯片行业的科技前沿，基于核心技术不断丰富技术储备，在包括 OLED 屏幕偏压驱动、3D TOF VCSEL 传感芯片及 3D 磁传感器等多个智能传感器芯片和电源管理芯片前沿应用领域实现了技术突破。

2、建立“Fabless+封装测试”业务模式，通过产业链协同为公司可持续发展赋能

在“Fabless+封装测试”的经营模式下，公司建设自有封装测试生产线，在研发、生产、质量方面与自身研发设计形成了显著的协同效应，具体情况如下：

① 研发协同

芯片研发是一个多次迭代循环的过程，需要经过反复的仿真、流片、封装测试、设计修改等过程，直至产品性能指标和可靠性达到设计要求。一款成熟芯片的开发可能需要进行多次流片、封装测试，由于涉及到晶圆厂及封装测试厂，时间周期及灵活度均存在一定不确定性。公司拥有自有封测产线，能够协同提升研发效率：其一公司自主研发了快速封装平台，能够根据新产品特点对封测设备、

模具等进行灵活、快速调整,加快对新产品的验证和测试,缩短新产品研发周期,提升新产品上市速度;其二通过深度参与芯片封测,公司能够在设计阶段充分评估封装策略以及封装对芯片应力等多项参数的影响,优化芯片设计方案,提升研发效率以及最终成品性能的高可靠性;其三公司在产品研发成功后就可立即转入批量生产阶段,实现研发、工程验证、批量生产的无缝衔接。

② 生产协同

公司拥有全流程封装测试服务能力,涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试等环节,能够大幅减少产品工艺流转、提升生产效率、缩短交付期限,尤其在上游封测产能紧张时,公司能够优先保证自研产品的生产,确保产品如期交付;公司能够根据产品特点布局生产工艺和产线,确保生产效率和产品质量,并且能够根据产品特点和客户需求对封测设备进行调校和改进,尤其是晶圆测试和成品测试环节,公司通过自主研发的测试程序和测试设备结合,能更好地满足定制化生产工艺和标准的要求,同时提高测试效率、降低成本。

③ 质量协同

采用 Fabless 模式的集成电路设计企业只从事集成电路的研发设计和销售,晶圆制造和封测完全依靠晶圆代工厂商和封测厂商的标准工艺,芯片的良品率和性能受供应商标准工艺的限制。公司经过长期研发积累,已形成“高可靠性封装技术”、“精准磁通量测试技术”等核心技术,能够根据自研产品的特点进行晶圆测试、封装、成品测试工艺流程的调整,提高产品良率和可靠性。以磁传感器芯片为例,为减小外部环境在封装过程中引入的磁场误差,公司对封装测试设备进行无磁化的定制改造,进一步确保磁传感器芯片性能的稳定性和可靠性。

3、良好的品牌美誉度,核心产品覆盖不同领域的知名客户

公司是“上海市专精特新中小企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市专利试点企业”,并进入工信部第二批专精特新“小巨人”企业名单。同时,公司凭借自身优异的产品性能和可靠的产品质量,核心产品覆盖了多产业链的知名客户。其中,智能传感器芯片在功耗、精度及可靠性等技术性能方面均表现优异并获得客户的认可,广泛应用于知名大小家电、数码消费品牌产品中;在电源管理芯片方面,公司凭借优良的电流精度、带载能力、输出效率奠定了电源管理产品的行业市场地位,产品已广泛应用于行业知名品牌手机、笔记本等数码消费电子

产品中。

4、产品种类丰富，能够满足不同领域不同客户的多样化需求

公司的产品种类丰富，包括智能传感器芯片和电源管理芯片两大板块、四大系列（磁传感器、智能电机驱动、光传感器、电源管理）、600 余款产品型号，可满足智能家居、智能手机、计算机和可穿戴设备等不同领域终端客户在不同使用场景的应用需求。

在智能传感器芯片领域，公司产品参数类别和下游应用领域较为广泛，其中磁传感器芯片感应灵敏度参数覆盖 5GS 至 200GS 范围，驱动电压参数也适配 12V、24V 和 36V 等电机马达工作电压环境，此外，主要终端使用场景已逐步扩充至智能手机、扫地机器人、水气表、散热风扇、TWS 耳机、平板电脑、智能电视和人脸识别智能支付终端等技术附加值高的应用领域；在电源管理芯片方面，公司立足核心产品屏幕偏压驱动芯片、闪光背光驱动芯片，持续跟踪终端客户需求，产品适用的终端产品类型丰富；同时公司不断进行技术研发和新产品储备，形成 MIPI 开关芯片、TypeC 转换接口芯片等产品。公司丰富的产品线能够满足下游客户尤其是大型电子设备制造厂商的多样化需求。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

不适用。

七、研发总体情况及研发进展

（一）研发投入情况

2023 年 1-6 月，公司研发投入具体如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	54,417,588.08	29,408,583.61	85.04
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	54,417,588.08	29,408,583.61	85.04
研发投入总额占营业收入比例（%）	28.43	9.15	19.27
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

本期研发费用同比上年同期增加 85.04%，主要原因是公司加大研发投入并

进行了股权激励，研发人员工资以及股份支付增加。

(二) 研发进展

公司 2023 年度各项在研项目正常开展，公司新获得实用新型专利 6 项。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已取得内地专利 80 项(其中发明专利 27 项)，港澳台及境外专利 16 项(其中发明专利 12 项)，集成电路布图设计专有权 80 项，软件著作权 7 项，形成完整的自主知识产权体系。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用（不含税）172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000678 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 73,968.94 万元。本年度使用募集资金 28,622.78 万元，收到存款利息扣除手续费后的净额 548.99 万元，理财产品收益 1,088.05 万元，购买理财产品余额 103,000 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 26,205.75 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额
中国银行上海市共和新路支行	455983337282	12,082.95
中国银行上海市共和新路支行	450783649068	4,212,448.21
中国银行上海市共和新路支行	433884222472	41,013.58
中国银行上海市共和新路支行	454684213048	0.00
交通银行上海市徐汇支行	310066179013005938420	1,043,719.29

中信银行上海市虹桥支行	8110201013801502001	591,606.26
中信银行上海市虹桥支行	8110201014501502008	271,193.74
中国工商银行上海市外滩支行	1001262119204694340	227,195.80
上海银行上海普陀支行	03005039982	11,618,686.49
嘉兴银行科技支行	8010800366666	244,039,508.96
合计	—	262,057,455.28

（二）募集资金使用是否合规

灿瑞科技 2023 年上年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，灿瑞科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月末，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股情况如下：

名称	职务	持股情况	减持情况	质押或冻结情况
景阳投资	控股股东	直接持有灿瑞科技 34,891,465 股	无减持	无质押或冻结
罗立权	董事长、实际控制人	直接持股 2,980,000 股；通过景阳投资间接持有公司 25.34%股权；通过上海骁微间接持有公司 6.42%股权；通过上海群微间接持有公司 4.69%股权	因权益分派，股权增加 980,000 股。	无质押或冻结
罗杰	董事、核心技术人员、总经理、副总经理（离任）、实际控制人	通过景阳投资间接持有公司 19.46%股权；通过上海骁微间接持有公司 0.01%股权；通过上海群微间接持有公司 0.01%股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.032%股权	无减持	无质押或冻结

余辉	董事、副总经理	通过景阳投资间接持有公司 0.45% 股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.071% 股权	无减持	无质押或冻结
黄俊	独立董事	无	无减持	无质押或冻结
徐秀法	独立董事	无	无减持	无质押或冻结
沈美聪	董事会秘书（离任）、副总经理	通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.024% 股权	无减持	无质押或冻结
宋烜纲	财务总监	通过灿瑞 2 号间接持有公司 0.004% 股权	无减持	无质押或冻结
林丽霞	副总经理、董事会秘书	无	无减持	无质押或冻结
吴玉江	监事会主席、核心技术人员	通过上海群微间接持有公司 0.26% 股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.012% 股权	无减持	无质押或冻结
彭军	监事	通过上海群微间接持有公司 0.13% 股权；通过灿瑞 2 号间接持有公司 0.004% 股权	无减持	无质押或冻结
郑小明	职工监事、核心技术人员	通过上海群微间接持有公司 0.16% 股权	无减持	无质押或冻结
郎伟	核心技术人员	通过上海群微间接持有公司 0.08% 股权；通过灿瑞 2 号间接持有公司 0.005% 股权	无减持	无质押或冻结

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励（第二类限制性股票）情况如下：

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
沈美聪	副总经理	-	10.4	-	-	10.4
余辉	副总经理	-	10.1	-	-	10.1
宋烜纲	财务总监	-	2.7	-	-	2.7
林丽霞	副总经理、董事会秘书	-	3.11	-	-	3.11
郎伟	核心技术人员	-	3.5	-	-	3.5
合计	/	-	29.81	-	-	29.81

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、 保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

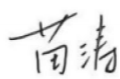
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司
2023 年度半年报持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



谢雯



苗涛

